

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年1月2日(02.01.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/005009 A1

(51) 国際特許分類:

C08G 73/06 (2006.01) *G03F 7/038* (2006.01)
C08G 73/22 (2006.01) *H05B 33/14* (2006.01)
C08K 5/00 (2006.01) *H10K 50/84* (2023.01)
C08L 79/04 (2006.01) *H10K 59/122* (2023.01)
C08L 79/08 (2006.01) *H10K 59/124* (2023.01)
G03F 7/023 (2006.01) *H10K 85/10* (2023.01)
G03F 7/037 (2006.01)

特願 2023-104746 2023年6月27日(27.06.2023) JP

(71) 出願人: 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 谷垣 勇剛 (TANIGAKI Yugo); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 馬場 修 (BABA Osamu); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 和田 達帆 (WADA Tatsuhō); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 佐伯 昭典 (SAEKI Akinori); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/022587

(22) 国際出願日: 2024年6月21日(21.06.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

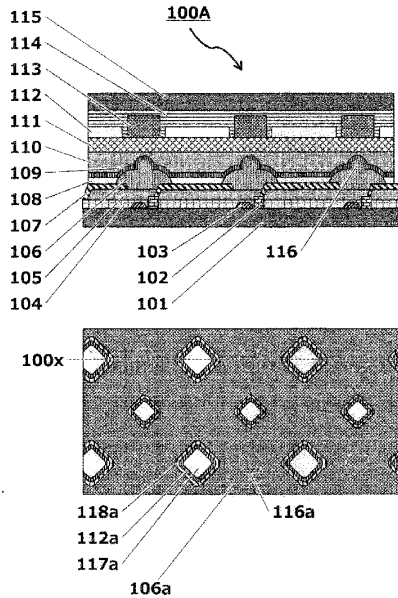
(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

(54) **Title:** RESIN, PHOTSENSITIVE COMPOSITIONS, CURED OBJECT, DISPLAY DEVICE, ELECTRONIC COMPONENT, AND METHOD FOR PRODUCING CURED OBJECT

(54) 発明の名称: 樹脂、感光性組成物、硬化物、表示装置、電子部品、及び硬化物の製造方法

【図1】



(57) **Abstract:** The purposes of the present invention are: to provide a photosensitive composition which can be inhibited from leaving residue after development; to provide a photosensitive composition which can give a cured object to be included in a display device that can be operated at a low voltage in obtaining a desired current density, has excellent light-emitting properties, and has excellent light-emitting-element reliability; and to provide a photosensitive composition

[続葉有]



WO 2025/005009 A1

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

which can give a cured object to be included in an electronic component having excellent migration resistance. This resin comprises one or more resins selected from the group consisting of polyimides, polyimide precursors, polybenzoxazole, polybenzoxazole precursors, poly(amide-imide)s, poly(amide-imide) precursors, and copolymers of these, and has a primary amine residue (DA1), which is an amine residue having a phenolic hydroxyl group. The primary amine residue (DA1) includes at least two cyclic structures having a phenolic hydroxyl group and further has a specific structure that connects the cyclic structures. This resin has a content of fluorine element in the structure of 10,000 mass ppm or less.

(57) 要約: 本発明は、現像後の残渣抑制が可能な感光性組成物の提供、所望の電流密度を得るにあたり低電圧駆動が可能な優れた発光特性を有し、発光素子の信頼性に優れる表示装置に具備される硬化物が得られる感光性組成物の提供、並びに、マイグレーション耐性に優れる電子部品に具備される硬化物が得られる感光性組成物の提供を目的とする。本発明は、ポリイミド、ポリイミド前駆体、ポリベンゾオキサゾール、ポリベンゾオキサゾール前駆体、ポリアミドイミド、ポリアミドイミド前駆体、およびそれらの共重合体からなる群より選ばれる一種類以上の樹脂であって、(DA1) 第1アミン残基: フェノール性水酸基を有するアミン残基を有し、該(DA1) 第1アミン残基が、少なくとも2つのフェノール性水酸基を有する環状構造を有し、さらにそれらを連結する特定構造を有し、該樹脂の構造中に占めるフッ素元素の含有量が10,000質量ppm以下の条件を満たす、樹脂である。